



Technical Data Sheet

- ▣ 제품명 ▪ BK-A 1000
- ▣ 제품 유형 ▪ 용제형 아크릴 점착제(이액형)
- ▣ 색 상 ▪ 무색 투명

☞ 제품을 사용하기 전에 점착제/경화제를 100/0.1 비율로 잘 섞은 후 사용하세요.

▣ 제품 물성

- 고형분 ▪ 약 30%
- 냄새(모노머) ▪ 없음
- 점도(30%) ▪ 2,200 ± 100 cps(22°C) / Brookfield viscometer(DV2T)

▣ CREEP TEST (Overlap area: 25 x 25 mm² / 1kg x 1 hour dwell time to stainless steel)

Stainless steel / 도포 두께		5 μ m	20 μ m	50 μ m
Hardener 0.10	Creep test-1	200°C (50%)	200°C (50%)	200°C (50%)
	Creep test-2	150°C	160°C	160°C

☞ Note: Creep 시험(1kg 추 사용)후의 시편이 아래로 밀리는 현상이 전혀 없음
 Creep test-1(전사와 관계없이 1시간 동안 유지한 온도), (%) SUS 판에 전사된 정도
 Creep test-2(1시간 동안 유지한 온도에서 전사가 없음)

▣ 피착제 별 점착력(180° Peel adhesion, 300mm/min at R.T.); UTM(500N)/ZwickRoell

피착제		5 μ m ~ 50 μ m (건조 후 도포 두께)
Hardener 0.10	SUS	0.40 ~ 1.90 kgf/in
	Glass	0.50 ~ 1.90 kgf/in

☞ Note: 시험 후 피착제에 전사 없음(5 μ m ~ 50 μ m 도포 두께)

▣ 경시점도 변화(경화제 투입량: 0.10%) / Brookfield viscometer(30% solids / 22°C)

	초기	1시간 후	2시간 후	4시간 후	8시간 후
점도	2,200 cps	2,480 cps	2,400 cps	2,420 cps	2,450 cps

▣ 저장기간 별 점착력(180° Peel adhesion, 300mm/min at R.T.); UTM(500N)/ZwickRoell

	테이프 제조 후 *	테이프를 SUS판 부착 후 **
초기	1.00 kgf/in	1.00 kgf/in
6개월 후	0.90 kgf/in	2.10 kgf/in

☞ Note: 도포 두께(20 μ m)

* 테이프 제조하여 6개월 경과 후, SUS판에 부착하여 점착력 시험(전사 없음)

** 테이프를 SUS판에 부착하여 6개월 경과 후, 점착력 시험(6개월 후 박리 시 전사 없음)

- ▣ 특 징:
 - 우수한 내열성(200°C x 1kg x 1시간 동안 creep 시험 후, 밀리는 현상 전혀 없음)
 - 적절한 점도와 함께 안정한 경시점도
 - 테이프를 피착제에 부착하고 장기간 보관 후에 박리하여도 전혀 흔적이 없음
 - 장기간 보관하여도 안정된 점착 성능
 - 다양한 피착제에 대한 우수한 점착성능

- ▣ 용 도:
 - Flexible Printed Circuit Board (FPCB)
 - 무연 solder reflow 공정(PCB 및 반도체)
 - 자동차 엔진 후드 내부 점착용



Technical Data Sheet

(내열성 시험)

- ▣ 제품명 ▪ BK-A 1000
- ▣ 제품 유형 ▪ 용제형 아크릴 점착제(이액형)
- ▣ 색 상 ▪ 무색 투명

☞ 제품을 사용하기 전에 점착제/경화제를 100/0.1 비율로 잘 섞은 후 사용하세요.

▣ 제품 설명

- **A사 제품**
 - 양면 테이프(아크릴 점착제/투명)
 - Temperature tolerance(Short / Long term) : 280°C / 177°C
 - 고온에 노출되는 전자인쇄 회로 기판 적용 가능
- **BK-A 1000**
 - 용제형 아크릴 점착제(이액형/투명)
 - Creep testing: >200°C (No slippage), 25 x 25 mm² x 20μm
 - ☞ 1kg x 1 hour dwell time to stainless steel
 - 용도: 내열성을 요구하는 Flexible Printed Circuit (FPC) 및 전자재료 등

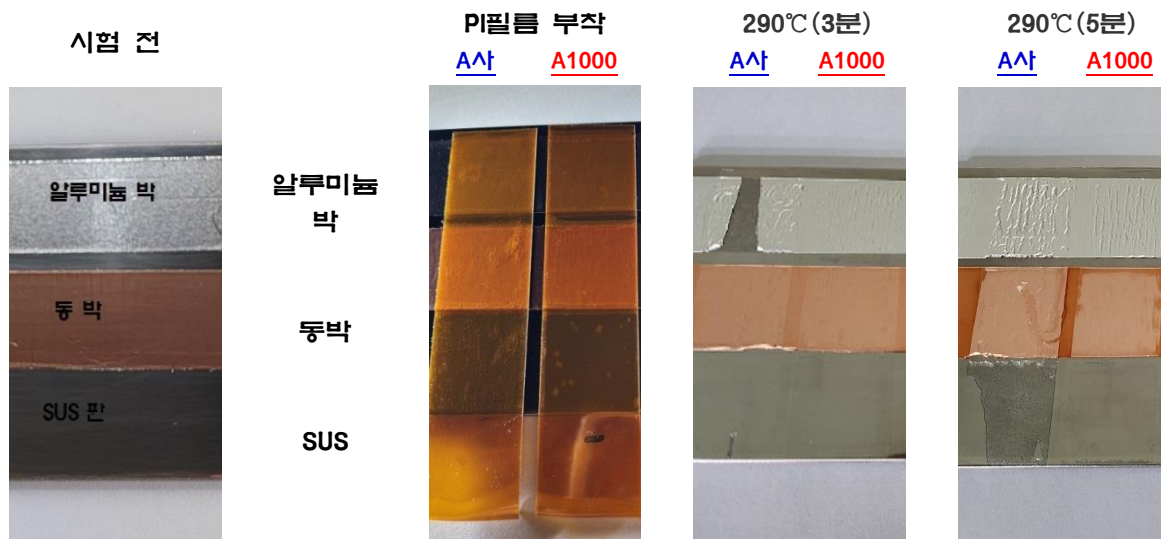
▣ 내열성 시험용 시편 준비

- **A사 제품** ▪ Tape를 PI 필름(25mm 폭)에 직접 부착
- **BK-A 1000** ▪ 점착제를 PI필름(25mm 폭)에 직접 도포
 - ☞ 도포 후 열처리 및 16시간 숙성하여 사용

▣ 내열성 시험 조건

- PI 필름 시편을 동박, 알루미늄박 및 SUS판에 부착 후 290°C에서 오븐에 방치
- 290°C x 3분 및 5분간 오븐에서 각각 방치
- 290°C x 3분 및 5분간 시험 후, PI 테이프를 제거하여 동박, 알루미늄박 및 SUS판에서 전사 및 흔적상태를 확인

▣ 시험 결과



▣ 메모